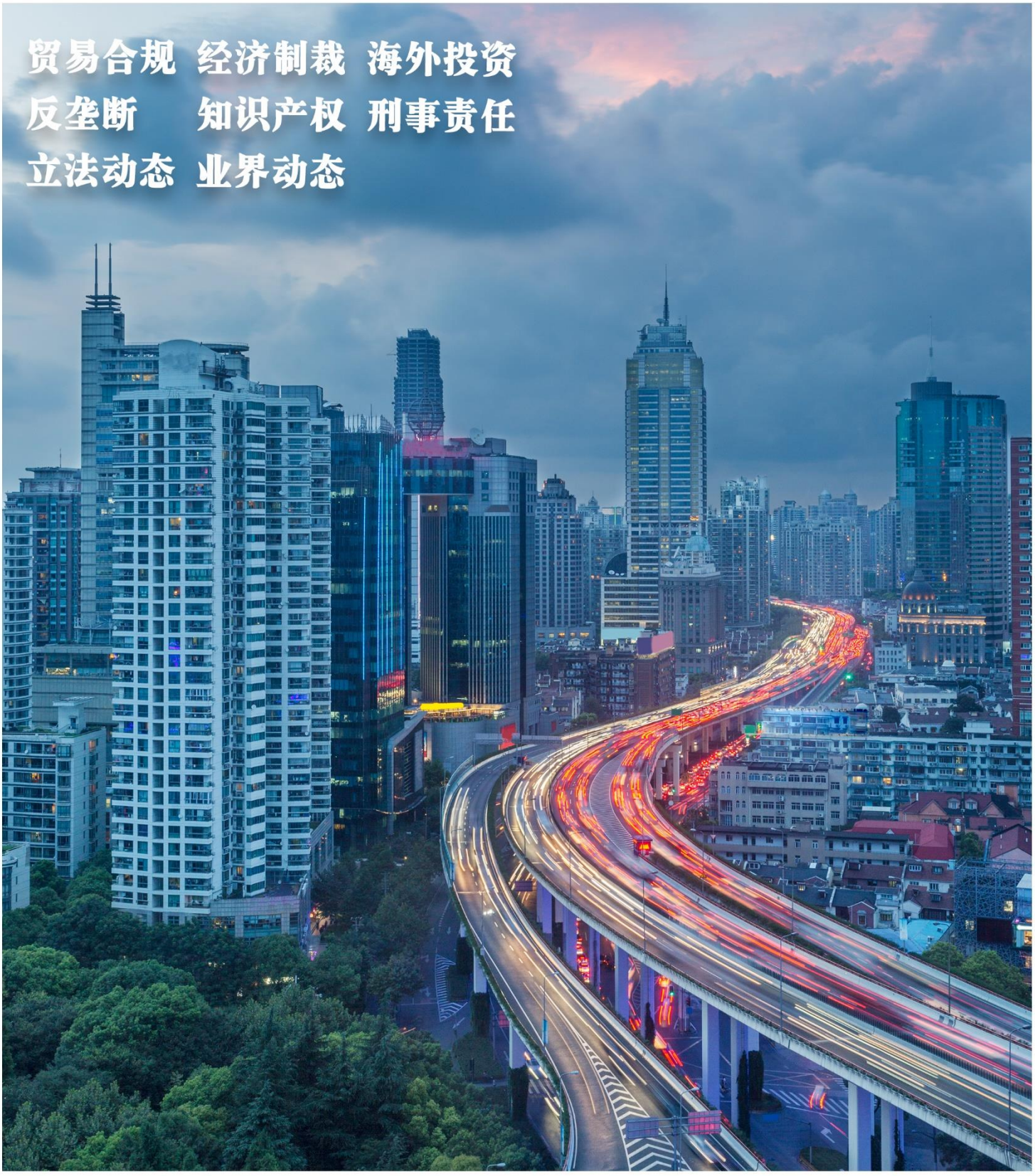
半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊（5月第1期，2021年总第9期）



目　录

一、 贸易合规/经济制裁 1

（一） 涉军企业清单调整为正式格式 1

（二） 箩筐技术在涉军企业名单诉讼中取得初步胜利 1

（三） 小米从涉军企业名单中移除 2

（四） SAP 因违反伊朗制裁规定，被罚 800 万美金 2

（五） Honeywell 因违反出口管制与美国务院达成和解 3

二、 海外投资 4

（六） 纽交所确认将中国三大电信公司退市 4

三、 反垄断 4

（七） 美消费者对美光、三星等提起集体诉讼，指控其操纵 DRAM 价格 4

四、 知识产权 5

（八） 联华电子与个人原告和解因美国司法部诉讼衍生的集体诉讼 5

五、 刑事责任 6

（九） 一中国公民因违反美国出口管制法认罪 6

六、 立法动态 8
（十） 欧盟即将实施出口管制新规 8
（十一） 韩国政府公布半导体强国建设战略规划 8
七、 业界动态 9
（十二） IBM 发布全球首个 2 纳米芯片制造技术 9
（十三） 美国半导体联盟成立，台积电加入 10

一、 贸易合规/经济制裁

（一） 涉军企业清单调整为正式格式[i]

当地时间 4 月 30 日，美国财政部宣布将中国涉军企业清单(Communist Chinese Military Companies List, CCMC 清单)由以前的临时格式调整为标准制裁清单格式。且从同一天起，CCMC 清单，作为 Non-SDN 清单的一种，可以在美国财政部制裁清单检索工具里查询，标号 CMCC-EO13959。

（二） 箩筐技术在涉军企业名单诉讼中取得初步胜利[ii]

5 月 5 日，箩筐技术在其官网发布声明，表示收到了来自美国哥伦比亚特区地方法院的裁决结果。该裁决暂停了美国国防部将箩筐技术认定为中国涉军企业的行政命令以及由该行政命令导致的限制。裁决立即生效。

此外，美国财务部于当地时间 5 月 6 日就箩筐技术的问题，发布了关于行政令 13959 的常见问题回复（Q893）。该问题回复指出，根据美国哥伦比亚地方法院的命令，初步暂停对箩筐技术执行行政令 13959，在法院作出进一步命令之前，该行政令中的禁止性规定不适用于箩筐技术。

（三） 小米从涉军企业名单中移除[iii]

当地时间 5 月 11 日，小米和美国防部联合向哥伦比亚特区联邦法院递交了报告(joint status report)，表示考虑到目前小米赢得了法院临时禁令，也考虑到国防部不会进一步上诉，国防部同意将小米从涉军企业清单中移除。报告中表示这种移除是适当的，能避免更多诉讼。

小米是在今年 1 月提起诉讼，不同意美国防部将其列入涉军企业清单，否认与中国军方有任何关联。

双方将就小米移除的最终命令条款进行谈判，最迟在 5 月 20 日向法院提交最终命令。

中集知联 ICIP 奥斯顿 ALSTON & BIRD

（四） SAP 因违反伊朗制裁规定，被罚 800 万美金[iv]

当地时间 4 月 29 日，美国司法部公布了一则新闻，因为违反出口管制相关法律，全球软件巨头 SAP 同意司法部、商务部和财政部支付超过 800 万美金的罚款。

在自愿披露中，SAP 承认违反《出口管理条例》(Export Control Administration)以及《伊朗交易和制裁条例》(Iranian Transation and Sanction Regulations)。自 2020 年 1 月起直至 2017 年 9 月至，SAP 在未申请出口许可的情况下，向伊朗用户发送了 2 万多次升级和软件补丁，并允许 2360 名伊朗用户访问位于美国的云服务。

因为自愿披露、在调查中的广泛合作以及支付了超过 2700 万美元的补救费用以加强合规措施，SAP 与马萨诸塞州联邦检察官办公室以及司法部国家安全司达成了不予起诉协议，除罚款外，SAP 还将上交 514 万美元的非法所得。

（五）Honeywell 因违反出口管制与美国务院达成和解[v]

当地时间 5 月 3 日，美国国务院发布公告，称其已与 Honeywell International, Inc.达成和解协议，以解决 Honeywell 涉嫌违反《武器出口管制法》(Arms Export Control Act)以及《国际武器贸易条例》(International Traffic in Arms Regulations, ITAR)的规定。

根据美国务院的拟议起诉函(proposed charging letter)，Honeywell 被指控未经授权向加拿大、爱尔兰、中国大陆和台湾出口和再次转移多张受 ITAR 管制的工程图。Honeywell 于 2015 年 12 月向国务院首次披露了前述违反行为，并在 2016 年 9 月的自愿披露中告知国务院其愿意采取的补救措施。2018 年 10 月，Honeywell 再次自愿披露了其员工在 2018 年 6 月至 7 月期间所从事的违反出口管制的行为。

根据目前达成的为期 36 个月的和解协议，Honeywell 将支付 1300 万美元罚款，其中 500 万美元暂停收取，以用作执行经批准的补救措施。除额外的合规措施外，Honeywell 还需在前 18 个月内，聘请一名外部合规官监督和解协议的执行，在和解协议期间，Honeywell 还需要对其合规体系进行一次外部审计。

二、 海外投资

（六） 纽交所确认将中国三大电信公司退市[vi]

5 月 7 日，中国移动、中国联通和中国电信三大运营商纷纷发布公告称，纽约证券交易所（“纽交所”）委员会维持了纽交所监管部门重新启动针对公司美国存托证券（ADR）下市程序的决定，预计纽交所将向美国证券交易委员会（SEC）申请允许这三家公司退市。而退市决定将在 SEC 收到相关申请表格 10 日后生效（关于三大电信公司摘牌一事在今年 1 月曾有过戏剧性反复，详见本半月刊 1 月第 1 期和第 2 期）。

三家电信公司表示，退市对于其并无实际影响。中国联通和中国电信的 ADR 占比，只分别为 0.2%和 0.14%，中国移动也表示 ADR 占量很小。

三、 反垄断

（七） 美消费者对美光、三星等提起集体诉讼，指控其操纵 DRAM 价格[vii]

当地时间 5 月 3 日，14 名购买了 DRAM 内存产品和笔记本电脑的个人原告在加州圣何塞提起诉讼，指控三星、SK 海力士以

及美光控制几乎 100%的 DRAM 市场，共同减少供应和放弃市场份额扩张，以获得巨大利润。这些个人消费者认为，他们为 DRAM 产品支付了虚高的价格，遭受了垄断的损害。

长达 147 页的诉状详细说明了被告如何联合行动扭转 2015 年大幅下降的 DRAM 价格，并导致该价格在集体诉讼提及的期间上涨了 350%。

整个诉状包括 20 项指控，声称被告违反了《谢尔曼法》、各州反垄断法、消费者保护法以及不公平竞争法。诉状要求获得集体诉讼的认定、陪审团审判、多项损害赔偿（包括违反联邦反垄断法的 3 倍损害赔偿）、禁令救济以及原告的律师费和诉讼费用。

中集知联 ICIP Alliance 奥斯顿 ALSTON & BIRD

四、 知识产权

（八） 联华电子与个人原告和解因美国司法部诉讼衍生的集体诉讼[viii]

5 月 4 日，台湾联华电子发布公告，因美国司法部起诉联华电子违反商业秘密保护，进而衍生的集体诉讼，原告已同意与联华电子和解，联华电子将支付 300 万美元作为集体诉讼和解基金。

公告中，联华电子称，原告 Kevin D. Mayer 于 2019 年代表其个人以及其他购买联华电子美国存托凭证之人士，在美国纽约南区联邦法院对联华电子以及相关高层经理人以违反美国证券法以及 10b-5 规则为由，提起集体诉讼。美国法院 5 月 3 日核准该集体诉讼和解，联华电子所支付的 300 万美元将分配给原告以及支付原告律师费等。

美国司法部起诉联华电子违反商业秘密的案件，已在 2020 年达成和解（详情请见半月刊 2020 年 10 月第 2 期）。

五、 刑事责任

（九）一中国公民因违反美国出口管制法认罪[ix]

中集知联 ICIP Alliance 奥斯顿 ALSTON & BIRD

根据美国司法部 4 月 28 日的新闻稿，44 岁的中国公民 Shuren Qin 在波士顿联邦法院认罪，涉嫌一起为西北工业大学非法采购和出口价值 10 万美元的美国原产产品。而西北工业大学被美国认为是一所中国军事大学，其深入并广泛地参与军事研究，并与中国人民解放军密切合作以提高其军事能力。

这名中国公民通过投资移民项目 EB-5 移民来到美国，目前居住在 Wellesley。他认罪的罪名包括：未能获得必要的出口许可而共谋从美国向西北工业大学出口物项；就其客户和自美国出口的零件种类，向执法人员做虚假陈述；洗钱；签证欺诈；及从美国向中国走私水中听音器。

Qin 设立了 LinkOcean Technologies, Ltd.，主要从美国、加拿大和欧洲进口水下和海洋应用的货物和技术至中国。西北工业大学早在 2001 年即被美国商务部以国家安全为理由加入实体清单。Qin 被认为与西北工业大学沟通并从该大学接受了任务，以获取用于反潜战的物项。2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间，Qin 致使至少 60 件水听器（用于探测和监测水下声音的设备）在没有获得所需的出口许可证的情况下从美国出口至中国。Qin 和其公司向美国相关制造商隐瞒了西北工业大学是真正的最终用户，并向美国政府提交了虚假的用户信息。就与出口水听器有关的款项，Qin 通过洗钱将超过 10 万美元从中国账户转移至美国账户。

此外，在 2016 年 7 月，在申请移除绿卡所附条件时，Qin 参与了签证欺诈，谎称自取得绿卡以后没有被捕、也未从事任何犯罪行为。此后，在调查时，Qin 两次向调查人员作出虚假陈述，特别是谎称没有任何在实体清单上的客户，但事实上，他的两个客户，即西北工业大学和国防科技大学都位列美国实体清单。

Qin 所涉嫌的罪名，合谋违反美国出口法律最高可判处 20 年监禁、3 年监督释放和 100 万美元罚款；签证欺诈和走私均可判处最高 10 年监禁、3 年监督释放和 25 万美元罚款；虚假陈述，最高可判处 5 年监禁、3 年监督释放和 25 万美元罚款；洗钱，最高可判处 20 年监禁、5 年监督释放和 50 万美元罚款。法官 Denis Casper 将根据量刑规则以及其他因素综合判断量刑，于 2021 年 9 月 8 日宣判。

六、 立法动态

（十） 欧盟即将实施出口管制新规[x]

当地时间 5 月 11 日，欧盟发布新闻稿，通过关于两用物项(dual-use items)新的出口管制法规。新规进一步加强对更广泛的新兴两用技术，比如网络监控工具的控制。新法规还加强了成员国和欧盟委员会之间的协调，以支持该法规在整个欧盟范围内有效实施。同时，通过引入对生产商进行尽职调查义务，新规定将促使企业在应对两用物项构成的国际安全风险方面发挥重要作用。

该法规将在欧洲议会和理事会签署后，在欧盟官方期刊上发布并于 90 天后生效。

中集知联 ICIP Alliance 奥斯顿 ALSTON & BIRD

（十一） 韩国政府公布半导体强国建设战略规划[xi]

据韩联社报道，当地时间 5 月 13 日，韩国政府在三星电子平泽工厂举行“K-半导体战略报告大会”，公布了旨在实现综合半导体强国目标的战略规划。

具体而言，韩国政府将携手相关企业，截至 2030 年在韩国构建全球最大规模的半导体产业供应链——“K—半导体产业带”，建立起集半导体生产、原材料、零部件、设备和尖端设备、设计等为一体的高效产业集群。作为此次战略规划的核心内容，该

产业供应链西部北起依次有板桥、器兴、华城、平泽、温阳等城市纵向相连，东部覆盖利川、龙仁、清州，呈“K”字形。

根据规划，韩国政府将为相关企业减免税负、扩大金融和基础设施等一揽子支援。其中对半导体研发和设备投资的税额抵扣率最高将提升至 40 至 50%和 10 至 20%。预计三星电子、SK 海力士等企业 10 年内将投资 510 万亿韩元（约合人民币 3 万亿元），今年的投资额将达 41.8 万亿韩元。

此外，韩国政府还计划新设 1 万亿韩元规模的半导体设备投资特别资金，以低息为企业设备投资提供支援。据预测，如能顺利执行规划，韩国半导体年出口额将从去年的 992 亿美元增加到 2030 年的 2000 亿美元，相关就业岗位也将增至 27 万个。

中集知联 ICIP Alliance 奥斯顿 ALSTON & BIRD

七、 业界动态

（十二） IBM 发布全球首个 2 纳米芯片制造技术[xii]

当地时间 5 月 6 日，IBM 宣布在实验室中成功制造出 2 纳米制程的芯片。与现有 7 纳米的芯片相比，2 纳米芯片在同等功率下将性能提高了 45%或在相同性能下减少了 75%的能耗。

这个 2 纳米芯片可以在 300 毫米的晶圆上安装 500 亿个晶体管，大约有指甲盖大小。IBM 解释到，增加每个芯片上的晶体管数量可以使它们更小、更快、更可靠。

而全球最大的芯片代工企业台积电最近表示，其 4 纳米芯片工艺将在今年年底进行风险生产，争取明年量产。而该公司目前也正在研发 3 纳米和 2 纳米芯片。

（十三） 美国半导体联盟成立，台积电加入[xiii]

当地时间 5 月 11 日，一个由半导体公司和半导体主要下游企业组成的跨行业联盟美国半导体联盟(Semiconductor in America Coalition,SIAC)宣布成立。该联盟呼吁国会领导人拨款 500 亿美元用于美国国内芯片制造激励和研究计划。SIAC 的使命是推进促进美国半导体制造和研究的联邦政策，以加强美国经济、国家安全和关键基础设施。

SIAC 主要重点是为美国芯片法(Chips for America Act)争取基金。这一法案在今年早些时候颁布，批准了所需的半导体制造激励措施和研究计划，但没有提供资金来源。

SIAC 的主要成员包括苹果、思科、戴尔、google、亚马逊、惠普、微软、AMD、Nvidia、美光、Intel、高通、博通、德州仪器、IBM、Marvell、Xilinx、ASML、ARM、三星、SK Hynix、应用材料、Cadence、Synopsys 等几乎美国所有知名半导体公司以及一些主要的下游厂商。

台积电和联发科技也加入了该联盟。

****

集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于 2016 年 1 月 20 日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）成立于 1893 年，在全球范围设有 13 家办公室，拥有约 800 多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

[i] 参见：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list/ns-ccmc-list。

[ii] 参见：https://www.luokung.com/cn/press/129.html 和 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/5671。

[iii] 参见：https://filehost.thompsonhine.com/uploads/DOD-Xiaomi_status_report_3ca3.pdf。

[iv] 参见：https://www.justice.gov/usao-ma/pr/sap-admits-thousands-illegal-exports-its-software-products-iran-and-enters-non。

[v] 参见：https://www.state.gov/u-s-department-of-state-concludes-13-million-settlement-of-alleged-export-violations-by-honeywell-international-inc/。

[vi] 参见：https://www.chinamobileltd.com/sc/file/view.php?id=247420，https://doc.irasia.com/listco/hk/chinatelecom/announcement/ca210507a.pdf 和 https://doc.irasia.com/listco/hk/chinaunicom/announcement/ca210507.pdf。

[vii] 参见：https://lawstreetmedia.com/tech/antitrust-class-action-accuses-micron-samsung-and-sk-hynix-of-manipulating-dram-market/。

[viii] 参见：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01?step=1&firstin=true&year=110&co_id=2303。

[ix] 参见：https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-illegal-exports-northwestern-polytechnical-university。

[x] 参见：https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/10/trade-of-dual-use-items-new-eu-rules-adopted/。

[xi] 参见：https://cn.yna.co.kr/view/ACK20210513002700881?section=economy/index。

[xii] 参见：https://newsroom.ibm.com/2021-05-06-IBM-Unveils-Worlds-First-2-Nanometer-Chip-Technology,-Opening-a-New-Frontier-for-Semiconductors。

[xiii] 参见：https://www.chipsinamerica.org/2021/05/11/semiconductor-industry-and-downstream-sector-leaders-form-coalition-to-secure-federal-investments-in-domestic-chip-manufacturing-and-research。